

国信证券股份有限公司

关于广东利扬芯片测试股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：利扬芯片
保荐代表人姓名：牟英彦	联系电话：010-88005258
保荐代表人姓名：太国强	联系电话：010-88005112

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐人”“保荐机构”）作为广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”“上市公司”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，负责利扬芯片可转换公司债券上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

2026 年上半年，国信证券对利扬芯片的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，已制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐人已与利扬芯片签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对利扬芯片开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2026 年上半年，利扬芯片未发生按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况。

序号	工作内容	实施情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	2026 年上半年，利扬芯片无违法违规或违背承诺的情况。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐人督导利扬芯片及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐人督导利扬芯片依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐人督导利扬芯片严格执行内部控制制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人督导利扬芯片严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	2026 年上半年，保荐人对利扬芯片的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2026 年上半年，利扬芯片及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生前述事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、	2026 年上半年，利扬芯片及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。

序号	工作内容	实施情况
	实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2026 年上半年，经保荐人核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2026 年上半年，利扬芯片未发生前述情形。
15	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2026 年上半年，利扬芯片不存在前述情形。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发人员流失的风险

集成电路产业发展迅速，工艺、技术及产品的升级和迭代速度较快，公司要保持持久的竞争力，必须不断加大人才培养和引进力度。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员严重匮乏。公司的测试解决方案开发、测试技术创新和前瞻性研究主要依托以核心技术人员为骨干的研发团队。公司测试技术复杂程度高、研发难度大，掌握这些技术需要多学科的知识积累和多年的技术沉淀。如果同行业竞争对手通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，或其他因素导致公司研发技术人员大量流失，将对公司经营造成重大不利影响。

2、技术泄密风险

公司所处的集成电路测试行业为典型的技术密集型行业，核心技术是企业保持竞争优势的基础，核心技术人员的稳定性及核心技术的保密性对公司的发展尤为重要。经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水平已跻身国内先进行列。公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了保密制度，与核心技术人员签署了保密协议，并对其离职后做出了竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但是由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势，对公司业务造成不利影响。

（二）经营风险

1、公司发展需持续投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型行业。为了扩大测试规模，保证充足的产能以满足订单需求，提高市场竞争力，公司需不断添置测试机、分选机和探针台等测试平台。如果公司未来不能获取足够的经营收益，或者融资渠道、规模受限，导致资金投入减少，可能对公司的发展和市场竞争力产生不利影响。

2、公司租赁房产产权存在瑕疵的风险

（1）公司向万兴汽配租赁的位于东莞市万江街道莫屋工业区厂房、办公室和宿舍未取得房产证，该等房屋项下土地为莫屋社区集体所有，并经该集体三分之二以上村民代表同意后出租给万兴汽配；万兴汽配未取得相应的规划及建

设许可证书和不动产权证书。

(2) 公司全资子公司利阳芯向东莞市九号科技有限公司（以下简称“九号科技”）租赁位于广东省东莞市东城区同沙社区裕园街 1 号的厂房、宿舍，该租赁房产项下集体土地为同沙居委会所有，未取得相应的使用权证书，租赁房产亦未取得房屋所有权证书。

上述租赁房屋公司已取得有关政府部门、相关街道及居委会、出租方的证明或确认，确保公司经营使用的稳定，但未来如果因出租方产权瑕疵、出租方违约或当地政府部门对相关土地进行重新规划而使得相关房产拆迁，则公司的厂房、办公室和宿舍存在被迫搬迁的风险，进而对公司的生产经营带来一定的不利影响，搬迁和临时停工都将造成一定的经济损失。

3、劳动力成本上升导致经营利润下滑的风险

随着社会经济的迅速发展和人力资源及社会保障制度的不断规范和完善，社会人均薪酬水平逐步提高。同时为保持人员稳定、吸收优秀人才，公司的员工薪酬待遇也可能进一步提高。劳动力成本上升可能会带来未来经营利润下滑的风险。

4、客户产品保管不善的风险

公司在为客户提供晶圆测试、晶圆磨切和芯片成品测试服务等集成电路技术服务过程中，需替客户保管晶圆和芯片，并承担保管风险。虽然公司已建立完善的仓储管理制度，并针对客户产品购买了财产保险以降低风险，但由于晶圆和芯片价值高，存放过程中对温度、湿度等环境要求高，若公司在保管期间因管理不善或其他原因导致晶圆或芯片遗失、毁损的，公司将承担赔偿责任，可能对公司经营业绩产生不利影响。

5、进口设备依赖风险

报告期内，公司产能持续增长，固定资产投资规模持续增加。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 ADVANTEST CORPORATION（爱德万）、Teradyne (Asia) Pte. Ltd.（泰瑞达）、TOKYO ELECTRON LIMITED（东京电子）等国际知名测试设备厂商，相关设备系公司开展业务的关键设备。截至本报告披

露之日，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦加剧，可能导致公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率波动的风险

公司测试的芯片种类和型号较多，使用不同测试平台的毛利率存在一定差异，产品结构、中高端测试平台收入结构的变化将影响公司主营业务毛利率。其次，公司成本结构中以固定性成本为主，主要包含测试设备折旧、厂房费用和电费等。若公司未来营业收入规模出现显著波动，或流失先进制程芯片测试项目等高毛利率业务，或新增测试/晶圆磨切设备稼动率较低，公司将面临毛利率波动的风险或无法维持现有毛利率的风险。

晶圆磨切技术服务目前尚处于起步增长阶段，营业收入相对较少，但是前期投入的生产设备形成固定资产、厂房装修形成的长期待摊费用自达到预定可使用状态之日起计提折旧摊销，且为开展该业务公司需要重新招聘并培训相关的生产人员，由此形成的人工成本与折旧摊销等成本均非完全变动成本，因此在业务开展初期公司晶圆磨切服务存在收入与成本不匹配的情形，进而导致公司该业务短期毛利率为负。

公司持续投入测试和晶圆磨切产能，固定资产规模不断增加将导致相应的年平均折旧及摊销费用等固定成本持续增长，由于产能爬坡需要一定的时间周期，如果未来市场需求增速低于预期或者市场开拓不力，将可能使得产能投入初期不能较快产生效益以弥补新增固定成本，从而导致公司存在毛利率水平下滑的风险。

2、应收账款回收风险

公司应收账款规模随公司业务规模扩大而增加。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款未来有可能进一步增加。如果公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

3、税收优惠政策变化及所得税税率上升的风险

公司及子公司上海利扬、东莞利扬、东莞利致、千颖电子均为高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率；香港利扬首个 200 万元港币盈利的利得税税率降低至 8.25%，其后的利润继续按 16.5%征税。若未来相关税收优惠政策收紧，或者公司及子公司未能持续满足高新技术企业资质要求，将对公司净利润造成一定不利影响。

4、负债金额及比例较高的风险

随着公司业务的扩张，公司不断加大固定资产的投入，并通过银行贷款、发行可转换公司债券、售后回租等方式弥补自有资金不足。公司上年度和本报告期末的资产负债率分别为 56.12%和 40.04%，虽随着可转换公司债券赎回使得负债比例有所降低，但仍处较高水平。公司需适度地控制负债规模、合理地调整资产与负债的匹配程度，否则可能发生偿债能力降低的风险。

（四）行业风险

1、集成电路行业周期性波动风险

公司主要业务是向集成电路行业中的芯片设计企业提供集成电路测试及晶圆磨切技术服务，公司发展与国内集成电路设计公司的发展高度相关。国内集成电路行业存在周期性波动的特点，如果未来行业出现周期性下行，则会对公司经营业绩产生不利影响。

2、集成电路测试行业竞争风险

集成电路产业链中存在第三方专业测试厂商、封测一体公司、晶圆代工企业、IDM 厂商和芯片设计公司等模式的厂商涉及晶圆测试、芯片成品测试业务。其中，晶圆代工企业、封测一体公司和第三方专业测试厂商都能对外提供晶圆测试或者芯片成品测试服务，都是服务于芯片设计公司；而 IDM 厂商和芯片设计公司主要为满足集团内部的测试需求来配置一定的测试产能。各类厂商的主营业务和技术特点各不相同，相比于其他四类厂商，国内第三方专业测试厂商起步较晚，分布较为分散且规模较小。中国台湾地区等境外各类测试厂商占据了主要的市场份额，公司市场占有率较低，面临和境外各类测试厂商竞争的压力。

3、不可抗力风险

地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力的下降。

（五）宏观环境（经济）风险

公司所处行业属于技术密集和资金密集型行业，与集成电路产业发展趋势密切相关，受国际政治、国内外宏观经济、市场环境走势变化等不确定性因素影响，可能带来行业整体供需结构变化，给公司业务造成不良影响。如果宏观经济环境下滑，中美贸易摩擦不断，或将致使下游终端行业的市场需求下降，对公司经营业绩造成不利影响。

（六）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司主要业务是向集成电路行业中的芯片设计企业提供测试/晶圆磨切技术服务，属于人才密集、技术密集和资金密集型行业，发展与国内集成电路设计公司的发展高度相关。受国际政治、国内外宏观经济、行业周期、市场环境走势变化等不确定性因素影响，可能带来行业整体供需结构变化，给公司业务造成不良影响。如果宏观经济环境下滑，中美贸易摩擦不断，或将致使下游终端行业的市场需求下降，对公司经营业绩造成不利影响。

公司持续投入主营业务相关产能，固定资产规模不断增加将导致相应的年平均折旧及摊销费用等固定成本持续增长，由于产能爬坡需要一定的时间周期，如果未来市场需求增速低于预期或者市场开拓不力，将可能使得产能投入初期不能较快产生效益以弥补新增固定成本。

综上可能导致公司存在持续业绩大幅下滑或亏损的风险。

四、重大违规事项

2026 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	356,328,505.82	284,036,747.38	25.45
利润总额	12,764,145.25	-8,946,556.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	15,374,943.06	-7,061,056.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,062,891.83	-6,759,610.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	148,139,712.35	100,788,676.45	46.98
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年末	本期末比上 年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,597,251,440.05	1,142,953,449.28	39.75
总资产	2,695,487,851.45	2,645,106,585.55	1.90
主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年 同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.10	-0.64	增加1.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.93	-0.61	增加1.54个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.11	13.13	减少2.02个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、公司 2026 年半年度实现营业收入 35,632.85 万元，同比增长 25.45%，创成立以来的历史新高；主要得益于：一方面，行业结构性景气延续，存储、汽车电子、工业控制、端侧智能化（AIoT 及 SoC）等领域的持续放量；另一方面，公司依托持续夯实的技术能力，与客户合作持续深化、粘性稳步提升，多家重点客户芯片相继完成导入并实现量产落地，共同推动营业收入实现增长。晶圆磨切业务作为公司集成电路测试的延伸，随着客户不断积累并实现量产，前期布局的产能逐渐释放，晶圆磨切业务收入较上年同期实现较大增长。

2、公司持续布局的产能陆续释放，使得营业成本端相关的折旧、摊销、人

工、电力等固定成本持续上升。

3、公司研发费用为 3,957.20 万元，研发投入占营业收入 11.11%，公司本报告期研发费用规模保持稳步增长，研发投入占营业收入比重有所下降，主要系报告期内营业收入实现较快增长，增幅显著高于研发费用增幅所致。随着前期技术积累与研发成果逐步落地转化，有效驱动业务规模与收入水平提升，进而摊薄当期研发投入占比。公司深耕集成电路领域，紧抓行业发展机遇，始终坚持以技术研发与持续创新为核心发展驱动力，通过持续稳定的研发投入夯实核心竞争力，以此打造多元优质客户矩阵，既汇聚行业内知名大中型企业，亦赋能高成长潜力中小企业，客户结构兼具行业影响力与发展成长性，为公司长期高质量发展提供坚实技术支撑。

4、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 14,813.97 万元，主要系公司所处行业整体运行稳健，客户资信状况良好，回款情况总体稳定，经营活动现金流量保持较好水平。

5、公司与合作伙伴构建深度协同的战略合作格局；伴随新老客户各类产品陆续量产，公司营业收入实现稳步增长，归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为 1,537.49 万元、1,306.29 万元，较上年同期实现扭亏为盈。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、测试平台优势

公司成立于 2010 年，经过 10 多年发展，积累了较多的测试平台，相比于国内其他独立第三方测试公司，公司测试平台类型较为多样和丰富，可满足市场上不同设计公司的测试需求，目前公司拥有爱德万 V93000、T2000、T5830、T53 系列、EVA，泰瑞达 UltraFLEX、J750、Magnum，致茂 33 系列，恩艾 STS、PXI 系列，华峰测控 STS8200、STS8300，胜达克 Astar，芯业测控 XT21、XT22、XT23

系列, 东京电子 P12、Precio XL, 东京精密 UF200、UF3000、AP3000, 科休 MT9510, 爱普生 8000 系列, 四方 8508, 鸿劲 1028C、9046LS、3012、3015 系列等测试设备, 具有数字信号芯片、模拟信号芯片、数模混合芯片、射频芯片等的测试能力。

2、本土市场客户资源及服务优势

经过多年的发展, 我国本土电子产业成长迅速, 已成为电子产品生产制造大国, 本土芯片设计企业的技术能力和市场能力迅速发展壮大, 成为公司最主要的目标客户群。相对于海外竞争对手, 公司一方面更加贴近、了解本土市场, 能够快速响应客户需求, 提供充分的服务支持, 可以稳步占据供应链的关键位置; 另一方面, 公司与本土电子产品制造企业在企业文化、市场理念和售后服务等方面更能相互认同, 业务合作通畅、高效, 形成了密切且相互依存的产业生态链。

由于集成电路行业具有技术含量高的特点, 并且集成电路设计企业为了抢占市场先机, 通常对测试企业的测试能力、质量管理体系、交期、服务效率等方面有着较为严格的要求。公司作为独立第三方专业测试企业, 拥有公正的身份立场, 具有较强的服务意识和较高的服务效率, 能够全面满足客户对测试公正立场的要求。公司高度重视对客户资源的管理与维护, 长期通过参与客户工程技术研讨、进行新产品试验等有效措施加强与客户的互动性, 通过测试为客户创造更多价值, 提升客户粘性; 同时, 基于产能保证、技术保密性和更换供应商的操作成本考虑, 这种战略合作一般具备较高的稳定性, 为公司业务的持续发展奠定巨大的优势, 是公司的核心竞争力之一。

3、贴近集成电路产业链的地缘优势

中国集成电路产业已获得长足发展, 在全球产业链中的地位举足轻重, 集成电路产业链的晶圆代工制造与芯片封装、电子终端产品分别集中于国内的华东、华南地区, 目前我国境内最主要的晶圆代工基地集中在华东, 包括中芯国际、上海华力、华虹半导体、台积电和华润上华等; 长电科技、通富微电等是以华东为中心的封装基地, 该等企业为国内芯片设计公司提供专业的晶圆代工和封装代工服务。

立足国家战略性新兴产业布局，公司分别以粤港澳大湾区（广东省东莞市）和长三角地区（上海市嘉定区）两个中心建立五个测试技术服务生产基地；特别值得一提的是，公司在测试技术服务上，在大湾区拓展以晶圆减薄、激光开槽、隐切等技术服务为左翼，筑牢主业根基；在服务效能上，贴近半导体产业链集群的地缘优势，深度嵌入区域产业链条，通过全流程技术服务的精耕细作，公司既贴近前端晶圆制造和封装实现快速响应，又能毗邻终端客户电子产品应用提供优质服务，树立行业品牌标杆。公司多年来持续在第三方专业测试领域深耕，具备高质量且高性价比的集成电路测试量产能力，稳定的核心技术团队，辐射上下游的快速响应能力，是核心竞争力的体现。

公司在地理上贴近集成电路产业中心，在产品质量、交货速度、个性化支持、售后服务等方面也得到了客户的充分认可。同时，公司拥有贴近集成电路产业中心的地缘优势，便于获取高素质研发人才的加盟，处于有利的竞争地位，形成了一定的品牌效应。

4、技术研发优势

公司在行业内具备一定的技术研发优势，拥有较强的自主研发测试方案的能力。高效、专业的测试方案需要企业具备深厚的技术底蕴和经验积累，公司长期致力于测试方案开发，具备在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案的核心开发能力。公司较早实现了行业内多项领先技术产品的测试量产，在给客户提供关键技术测试方案上具有突出表现，为客户抢占市场先机及提升竞争力提供有力保障。

公司已经在工业控制、汽车电子、计算类芯片、5G 通信、传感器、存储、智能控制、生物识别、信息安全、北斗导航等新兴产品应用领域取得测试优势，展望未来，公司将围绕光通信芯片（激光器芯片、探测器芯片、硅光芯片等）、存储芯片（NOR/NAND Flash、DDR、HBM 等）、高算力/人工智能芯片（CPU、GPU、NPU、DPU、ISP、ASIC 等）展开，聚焦“光存算”集成电路测试领域，同时持续拓展智能物联网（AIoT）、汽车电子、MEMS 传感器、光谱芯片、无人驾驶、具身智能、工业控制、5G/6G 通信等领域集成电路测试业务。

为了保障公司具备长期的市场竞争力，公司高度重视技术的持续创新。未来，

公司将进一步增强研发能力，提升现有核心业务的技术水平，开发更多的新型集成电路测试方案，为客户提供更优质的服务，巩固和扩大自身的竞争优势。

5、人才优势

公司拥有多名在集成电路测试行业从业经验长达十余年的资深技术人员和专业的集成电路测试方案开发团队，构成公司技术研发的核心支柱力量；另外，公司早在 2019 年已组建先进技术研究院，专注于当前和未来集成电路行业先进制程、先进封装、先进应用的芯片产品做前瞻性测试研究。公司研发团队具备扎实的研发功底和经验积累，有利于提升公司的自主创新能力，通过不断开发出更具创新性的测试方案，赢得市场广泛认可，为公司带来更多的业务需求。

公司依托专业的研发团队，具备扎实的技术储备和丰富的行业经验。公司核心技术人员主要来源于自主培养，已形成由初级、高级、资深工程师组成的人才梯队，能满足公司技术在快速发展时期对测试人才源源不断的需求。

集成电路测试行业参与者需要具备丰富的测试经验，以提高测试品质的可靠性和对新产品需求的响应速度，能够在较短的产品开发周期内快速开发出满足市场应用的测试方案，以适应测试方案的需求并实现大规模批量测试。公司研发团队能开发基于多种高端测试平台的解决方案，并可实现各平台之间的转换，具备丰富的各种类型芯片产品测试方案的开发经验。

同时，公司还拥有较强的自动化设备硬件开发团队，公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D 高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到公司的生产实践中，其中 3D 高频智能分类机械手能够有效解决先进工艺离散性技术难题，目前仍处行业领先地位。

6、公司与第三方专业测试服务厂商的比较优势

与同为第三方专业测试厂商的其他公司相比，一方面，目前中国台湾存在多家规模较大的专业测试上市公司，如京元电子、矽格、欣铨等，与台湾测试公司相比，公司具有区位和文化优势，目前中国大陆为全球最大的电子产品市场之一，中国大陆的芯片设计公司也迎来高速成长。由于芯片设计公司需要与

集成电路测试公司进行密切的合作，在测试的过程中需要深入沟通具体技术问题，考虑到芯片设计领域的技术保密性，国内越来越多的大型芯片设计公司未来会逐渐将测试需求转向国内，优先选择国内的测试公司；另一方面，公司与国内第三方专业测试厂商相比，由于国内第三方专业测试厂商普遍成立时间较晚，规模较小，公司具有一定的规模优势和市场开拓优势。

7、公司与封测一体公司、晶圆代工企业、IDM 厂商、芯片设计公司的比较优势

（1）与封测一体公司相比：封测一体公司更多专注于封装领域的研发，其测试更多是属于自检，也就是在封装完成后进行配套测试检验，测试的内容主要是芯片的基本电性能测试和接续测试。公司作为独立第三方专业测试公司，专注于测试领域的研发，且多为自主研发测试方案，在测试服务技术实现路径上与封测一体公司存在差异；公司在产业链的位置为独立第三方，仅提供专业测试服务，测试报告更加中立、客观；

（2）与晶圆代工企业相比：独立第三方专业测试公司可选择的测试平台相对较多，具有较高的匹配度，交期也具有明显优势；

（3）与 IDM 厂商相比：独立第三方专业测试可接受订单的范围较广，IDM 厂商通常不接受外部订单，测试产能规划全部服务于集团内部设计和制造的产品，相比于 IDM 厂商，公司测试服务客户范围更加广阔；

（4）与芯片设计公司相比：鉴于对商业和技术机密的保护，同类产品的芯片设计公司通常不会将测试需求交付于此种模式的测试厂，因此此类测试厂有业务开展的局限性，扩张潜力不足，产能利用率不高。而公司可与各类设计公司合作，业务开展较广，测试平台稼动率较高。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变化幅度(%)
费用化研发投入	39,571,955.36	37,307,385.08	6.07
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	39,571,955.36	37,307,385.08	6.07
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.11	13.13	减少2.02个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

报告期内，公司进一步加强创新能力建设和研发投入，具体专利和软件著作权的进展情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	5	129	56
实用新型专利	15	5	308	230
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	2	1	33	32
其他	0	0	0	0
合计	23	11	470	318

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

发行名称	2024 年广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 7 月 8 日

本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	52,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	711.09
二、募集资金净额	51,288.91
减：以前年度已使用金额	49,584.14
本年度使用金额	1,794.97
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.96
其他	0.00
加：募集资金利息收入	94.16
其他	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的直接持股及其变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	2026 年初持股数	2026 年 6 月末持股数	股份增减变动量	增减变动原因	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
黄江	董事长	56,227,935	53,948,510	-2,279,425	个人资金需求	-	-
黄主	董事	5,159,900	5,159,900	-	-	-	-

姓名	职务	2026 年初 持股数	2026 年 6 月末持股 数	股份增减 变动量	增减变 动原因	质押、标记或冻结情 况	
						股份状态	数量
张亦锋	董事、 总经 理、核 心技术 人员	378,133	378,133	-	-	-	-
辜诗涛	董事、 董事会 秘书、 财务总 监、核 心技术 人员	1,670,100	1,670,100	-	-	-	-
袁俊	董事、 核心技 术人员	343,803	343,803	-	-	-	-
黄帝祺	职工代 表董事	-	-	-	-	-	-
刘子玉	独立董 事	-	-	-	-	-	-
徐建明	独立董 事	-	-	-	-	-	-
郭群	独立董 事	-	-	-	-	-	-
卢旭坤	研发部 总监、 核心技 术人员	22,073	-	-22,073	个人资 金需求	-	-
郑朝生	硬件部 总监、 核心技 术人员	5,000	-	-5,000	个人资 金需求	-	-

注：黄江为公司董事长，亦为公司控股股东、实际控制人

报告期内，公司董事长黄江先生持有的股份减少 2,279,425 股；研发部总监、核心技术人员卢旭坤先生持有的股份减少 22,073 股；硬件部总监、核心技术人员郑朝生先生持有的股份减少 5,000 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，除上述情形外，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员持有的公司股份不存在其他减持、质押、冻结的情形。

十一、本所或者保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东利扬芯片测试股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


牟英彦


太国强

